

2015 年 3 月 25 日

各 位

J X 日 鉱 日 石 金 属 株 式 会 社

台湾における無電解 UBM めっき受託加工サービスの開始について

J X 日 鉱 日 石 金 属 株 式 会 社（本社：東京都千代田区大手町二丁目、社長：大井滋）は、台湾の半導体業界における顧客サービス拡充を目的に、子会社である台湾日鉱金属股份有限公司（本社：台湾桃園市龍潭、総経理：諏訪邊武史）龍潭工場において、無電解 UBM*めっき受託加工サービスを開始しましたので、以下のとおりお知らせいたします。

1. 目的

台湾には、世界を代表するファウンドリー（半導体受託製造企業）をはじめ、数多くの半導体製造企業があり、半導体産業の成長と技術の高度化にともない、UBM めっきの需要拡大が見込まれています。当社は 2008 年より本サービスを磯原工場（茨城県・北茨城市）で提供してまいりましたが、既に台湾の顧客への販売が定常化していることと、台湾における今後の新たな需要の伸びに対応するため、龍潭工場にも同様のプロセスを導入いたしました。これにより、納期の短縮など台湾における顧客サービスの一層の拡充を図ることができます。

2. 技術の特長

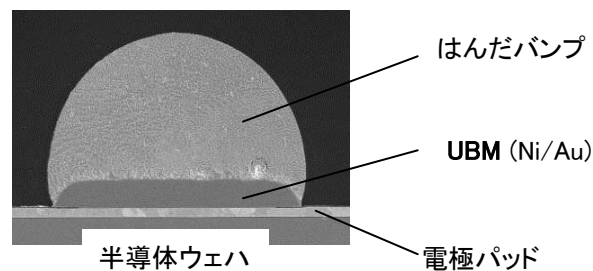
当社独自のめっき液およびプロセスによる無電解めっきは、選択的なめっき、バッチ処理により、低コスト・短納期を実現する技術です。

3. 今後の展開

今般、龍潭工場には磯原工場と同一のプロセスや装置を導入しており、今後は日本と台湾の 2 拠点でのサービス提供が可能となるため、BCP（事業継続計画）の視点からも体制が強化されました。当社グループでは、今後も顧客サービスの向上および安定供給体制の確立に努めてまいります。

* UBM (Under Bump Metallurgy アンダー・バンブ・メタラジー) :

半導体前工程で回路が形成されたウエハの電極パッド上に、はんだの密着性を上げるためにつける金属膜 (めっき)。半導体パッケージング技術の小型化、高集積化に伴い LSI や IC などのチップの接合方法として採用が拡大している「フリップチップ法」においては、UBM の形成が必須とされている。



(ご参考)

1. 台湾日鑛金属股份有限公司龍潭工場の概要

- (1) 所在地： 台湾桃園市龍潭
- (2) 従業員数： 約 190 名 (2014 年末時点)
- (3) 工場面積： 敷地面積 約 30,000 m²
- (4) UBM めっき加工の開始時期： 2015 年 3 月

2. 台湾日鑛金属股份有限公司の概要

(1) 代表者

董事長： 堀 一浩

總經理： 諏訪邊武史

(2) 資本金ならびに株主

資本金： 63.5 百万台湾元

株主： J X 日鉦日石金属株式会社 83.7%

J X 金属商事株式会社 15.0%

J X 日鉦日石コイルセンター 1.3%

(3) 主要拠点

本社・龍潭工場： 桃園市龍潭区龍園一路 88 號

觀音工場： 桃園市觀音区經建四路 45 號

彰濱リサイクルセンター： 彰化縣線西鄉安南三路 3 號

台中營業所： 台中市西区公益路 161 號 13 樓之 4

台南營業所： 台南市善化区光復路 496 號

(4) 事業内容

電子材料製品の製造および販売

金属加工製品のスリット・販売

各種工業品の販売

金属スクラップおよび故銅等の集荷・販売

電子部品、スラッジ類など含金属リサイクル原料の集荷・処理



龍潭工場

以上

關於公司開始在台灣提供之無電解 UBM 鍍膜代工服務

各位媒體先進：

本公司 J X 日鑛日石金屬株式會社 (總公司：日本國東京都千代田區大手町二丁目 社長：大井滋) 為了提升對台灣半導體產業客戶之服務，子公司台灣日鑛金屬股份有限公司 (總公司：台灣桃園市龍潭 總經理：諏訪邊武史) 的龍潭工場開始提供無電解 UBM * 1 鍍膜代工服務。

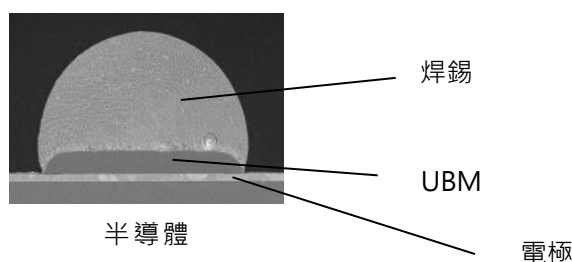
台灣擁有眾多具全球代表性的代工廠等半導體生產廠商，隨著半導體產業的成長與技術的進步，預估 UBM 鍍膜的需求也將隨之增加。本公司 2008 年起於磯原工場 (日本國茨城縣北茨城市) 提供此服務，但基於對台客戶的銷售情況穩定，並因應今後的需求成長，遂將相同製程引進台灣桃園龍潭工場，藉此可縮短交期，提升對客戶的服務品質。

本公司自行研發的鍍膜液及獨特製程之無電解鍍膜技術，是藉由選擇性鍍膜和批次處理，來達到低成本、短交期的目的。

從 BCP(事業永續計畫) 的觀點來看，此次龍潭工場引進與磯原工場相同之製程與設備，未來可由日本與台灣 2 個據點來提供代工服務，等於是強化了公司體制。本公司集團今後將更加努力，提升對客戶的服務品質，並確立穩定供貨體制。

*1 UBM (Under Bump Metallurgy 凸塊下冶金層)：

半導體前製程中，在已形成電路的晶圓電極焊點上，會鍍上一層金屬膜以提升焊錫的密著度。隨著半導體封裝技術的小型化、高集積化，LSI 或 IC 等晶片的接合方法中，被擴大採用的「覆晶法」就必須使用 UBM 製程。



(參考資料)

台灣日鑛金屬股份有限公司龍潭工場概要

- (1) 地址： 台灣桃園市龍潭
- (2) 員工人數： 約 190 名 (2014 年底時)
- (3) 工場面積： 佔地 約 30,000 m²
- (4) UBM 鍍膜代工服務開始時間： 2015 年 3 月

台灣日鑛金屬股份有限公司概要

(1) 代表人

董事長： 堀 一浩

總經理： 諏訪邊武史

(2) 資本額及股東

資本額： 新台幣 63.5 百萬元

股東： J X 日鑛日石金屬株式會社 83.7%

J X 金屬商事株式會社 15.0%

J X 日鑛日石分條中心 1.3%

(3) 主要據點

總公司龍潭工廠： 桃園市龍潭區龍園一路 88 號

觀音工廠： 桃園市觀音區經建四路 45 號

彰濱回收中心： 彰化縣線西鄉安南三路 3 號

台中營業所： 台中市西區公益路 161 號 13 樓之 4

台南營業所： 台南市善化區光復路 496 號

(4) 事業內容

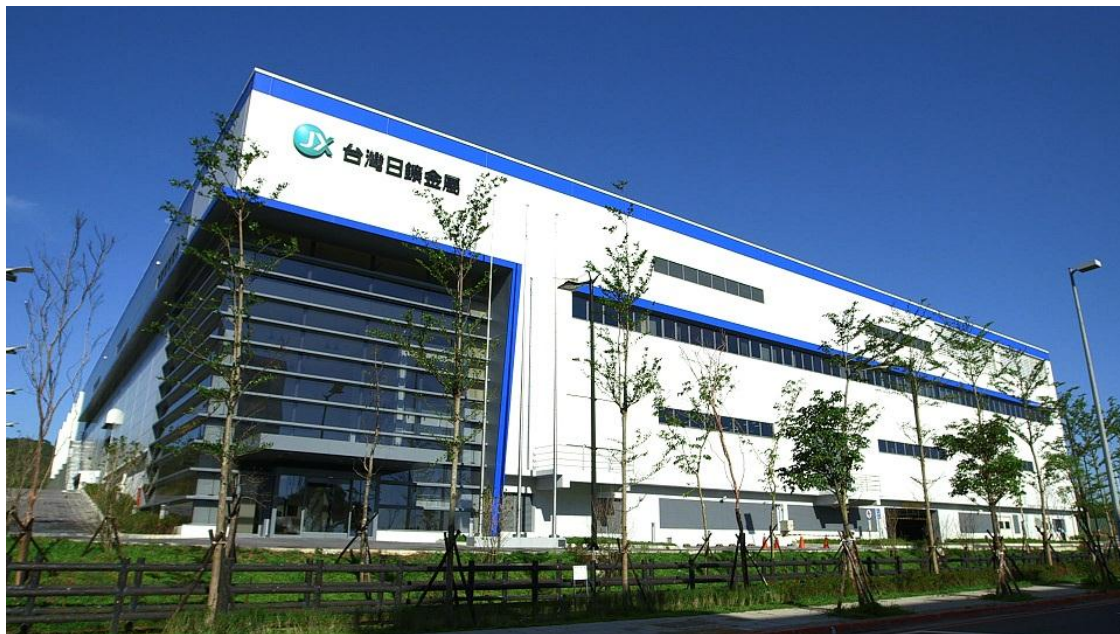
電子材料產品之產銷

金屬加工製品之裁切、銷售

各種工業品之銷售

金屬廢料及廢銅等之回收、銷售

電子零件、汙泥沈澱物等含金屬回收原料之回收、銷售



龍潭工場

此致

J X日鐵日石金屬株式會社

2015 年 3 月 25 日